

【原因、判断要点、发生工序】电镀液の成份、电镀时间、镀液温度、PH、添加剂、阴极摇动、辅助电极等的管理不善而引起的（镀铜工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by improper control of the plating conditions, such as solution composition, plating time, bath temperature, pH, additives, cathode oscillation, auxiliary electrode, etc (Copper plating process)

4-2 金めっき欠陥／镀金层缺陷／Gold plating defects

4-2-1 異物起因（金めっき欠陥）／杂物起因（镀金层缺陷）／ Caused by foreign objects(gold plating defects)

4-2-1-1 金めっき不付／金层不粘结／No gold deposit

【特徴】 金めっきが部分的に析出していない状態の欠陥

【特征】 镀金层的局部不沉积的缺陷。

【Characteristics】 Gold is not deposited locally.

【原因・判断ポイント・発生工程】 金めっき下地に異物が付着していたり、金めっきリードが断線したことにより出来たもの（导体回路形成工程～金めっき工程）

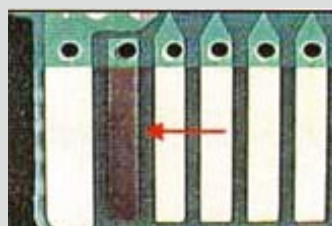
【原因、判断要点、发生工序】 镀金层的基底附着杂物、或者镀金引线开路所引起的（图形转移工序～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by attachment of a foreign object on the basis metal surface or a broken plating lead (Conductor pattern formation - gold plating process)



【コメント】 顕微鏡倍率 ×
【注釋】 顕微鏡倍率 ×
【Comments】 Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率 ×
【注釋】 顕微鏡倍率 ×
【Comments】 Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率 ×
【注釋】 顕微鏡倍率 ×
【Comments】 Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率 ×
【注釋】 顕微鏡倍率 ×
【Comments】 Magnification: ×